

中微半导体设备（上海）股份有限公司独立董事

关于对外担保情况的专项说明

根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等法律法规及《公司章程》的有关规定，作为中微半导体设备（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们本着实事求是、认真负责的态度，对公司 2019 年对外担保的情况进行了核查和落实，现发表专项说明如下：

截止 2019 年 12 月 31 日，公司对外担保金额共计为 4.04 亿元，全部为对子公司南昌中微半导体设备有限公司的担保，该担保事项已经公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过。2019 年内，公司未出现违规对外担保的情况，没有损害公司及股东，特别是中小股东的利益的情形。

2020 年 4 月 15 日

（以下无正文）

(本页无正文，为《中微半导体设备（上海）股份有限公司独立董事关于对外担保情况的专项说明》的签署页)

鉴于此，各董事已于首页所载日期签署本决议。

陈大同

签署：

A handwritten signature in black ink, appearing to be '陈大同', written over a horizontal line.

（本页无正文，为《中微半导体设备（上海）股份有限公司独立董事关于对外担保情况的专项说明》的签署页）

鉴于此，各董事已于首页所载日期签署本决议。

Chen, Shimin（陈世敏）

签署：

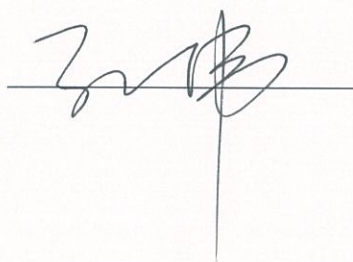
Handwritten signature of Chen Shimin in black ink, written over a horizontal line. The signature is stylized and cursive, appearing to read '陈世敏'.

（本页无正文，为《中微半导体设备（上海）股份有限公司独立董事关于对外担保情况的专项说明》的签署页）

鉴于此，各董事已于首页所载日期签署本决议。

孔伟

签署：

A handwritten signature in black ink, appearing to be '孔伟', is written over a horizontal line. A vertical line extends downwards from the end of the signature.

(本页无正文，为《中微半导体设备（上海）股份有限公司独立董事关于对外担保情况的专项说明》的签署页)

鉴于此，各董事已于首页所载日期签署本决议。

张卫

签署：